**集成电路材料全国重点实验室**

**开放课题申请书**

**课题名称：**

**课题编号：暂无**

**课题负责人：**

**承担单位：**

**课题执行时间：2024年7月-2026年6月**

**集成电路材料全国重点实验室开放课题申请书**

|  |  |
| --- | --- |
| **课题名称** |  |
| **申请经费额度** |  万元 | 研究期限 | 年 |
| **课题类型** | □ 大硅片及相关基础研究 □ SOI材料应用□ 异质集成衬底材料研发（XOI异质集成材料、超导材料、半导体相变材料等）□ 晶圆级工艺与封装材料研发□ 集成电路材料前沿技术研究（拓扑材料、二维材料、量子材料等） |
| **负****责****人** | 姓名 | 性别 | 职称 | 所学专业 | 最后学位 | 学位取得时间 | 授予单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 证件类型 | 证件号码 | 国别 | 出生日期 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 通信地址 | 邮政编码 | 手机 |
|  |  |  |  |
| **立项意义，研究内容,技术路线和年度计划：** |
| **协同合作设想：** |
| **现有工作基础（**着重描述课题负责人近五年与本课题有关的科研成果，包括但不限于第一/通讯作者学术论文、第一申请人专利、技术文档等**）：** |
| **平台条件：** |
| **预期年度成果：** |
| **经费预算**

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **经费** |
| 材料费 |  |
| 测试加工费 |  |
| 差旅费 |  |
| 会议费 |  |
| 出版、文献、信息传播、知识产权 |  |
| 专家咨询 |  |
| 劳务费 |  |
| 高级访问学者费 |  |
| 其他费用 |  |
| 合计 | 万 |

 |
| 申请人所在单位意见：公章年 月 日 |
| 实验室学术委员会审核意见：年 月 日 |
| 备注 | 申请书一式两份盖章后寄回，电子申请书发到下面邮箱联系人：张真真地址：上海市长宁路865号8号楼802邮编：200050电话：021-62511070-8802手机：18621561270E-mail：zzzhang@mail.sim.ac.cn |